

Niederdruck-Plasmaanlage V10-G

Leistungsfähiges Batch-System zur Entfernung von Fotolack



Die Niederdruck-Plasmaanlage V10-G ist mit einer Schiebetür und einer Prozesskammer aus Quarzglas ausgestattet und kann auch für die Reinigung von Wafern eingesetzt werden.

Die Batch-Anlage V10-G wurde zur Entfernung von Fotolacken konzipiert und ist darüber hinaus sehr gut für die Waferreinigung geeignet.

Anwendungen

- Hervorragend geeignet zur Entfernung von Fotolackschichten (auch SU-8) nach Trockenprozessen wie RIE oder Elektronenstrahlätzen sowie nach High-Dose-Implantation
- Zur Verbesserung der Benetzbarkeit vor Nassprozessen können Siliziumwafer oder andere Substrate behandelt werden
- Einsetzbar für Prozesse in der MEMS- und Nanotechnologie
- Entfernen von Polymerresten nach dem Bosch-Prozess
- Entfernen von organischen Opferschichten
- Konditionierung von bioaktiven Schichtaufbauten

Systemeigenschaften

- Prozesskammer: Quarzglas
- Schiebetür
- Anlagensteuerung: SPS (S7-300)
- Resistiver Touch-Panel mit Windows-Betriebssystem (auch mit Handschuhen bedienbar)
- Automatik- und Handbetrieb
- Grafische Anzeige aller prozessrelevanten Parameter
- Zugriffsberechtigungen individuell über Benutzergruppen
- Archivierung aller Prozesse
- Fernwartung (VPN)
- Ethernet-Schnittstelle

Optionen

- Vakuumpumpe
- Ozonfalle
- Bis zu zwei weitere Gaseinlässe
- Soft-Start und Slow-Vent
- Faraday-Käfig
- Prozessdruck-Regelventil

Technische Daten

Anlagenabmessungen (B x T x H): 720 x 820 x 820 mm

Kammerabmessungen (Ø x T): 215 x 260 mm

Plasmaanregungsfrequenz: Mikrowelle (2,45 GHz)

Mikrowellenleistung: 50-600 W

Gaseinlässe mit Mass-Flow-Controller: 1 Kanal

Elektrischer Anschluss: 400 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung (ohne Vakuumpumpe): 1,5 kVA

Druckmessung: Pirani

Gewicht: 150 kg



PiNK GmbH Thermosysteme

Am Kessler 6
97877 Wertheim
Germany
T +49 (0) 93 42 919-0
F +49 (0) 93 42 919-111
plasma-finish@pink.de
www.pink.de